

Agenda

Dienstag, 19. Mai 2026

SEHO Systems GmbH | Frankenstr. 7 – 11 | 97892 Kreuzwertheim

Die Teilnahme ist kostenlos.
 Alle Informationen und die
 Möglichkeit zur Anmeldung
 finden Sie auf der Event-
 Webseite:
<https://www.seho.de/xtron/>



9:00 Uhr Get together: Willkommen bei SEHO.

9:30 Uhr Begrüßung und Einführung in den Tag.

9:40 Uhr **Prozessintegrierte Überwachung des Flussmittelauftrags**
 Markus Hermann | SIEMENS AG Erlangen
 Arne Neiser | SEHO Systems GmbH

Der Flussmittelauftrag ist ein entscheidender Schritt im Wellen- und Selektivlötprozess. Für eine stabile Lötqualität sind sowohl die richtige Menge als auch die genaue Positionierung wesentlich. Bisherige Kontrollmethoden basieren meist auf Stichproben oder der Überwachung der Düse, liefern aber keine zuverlässige Information über den tatsächlichen Auftrag auf jeder einzelnen Leiterplatte.

Aus wissenschaftlicher und aus Anwendersicht beleuchtet dieser Vortrag eine neue Methode, die eine inlinefähige, automatisierte Prüfung direkt im Prozess ermöglicht.

10:10 Uhr **Zwischen optimalem Lötprofil und Produktionsausfall liegt ein Mysterium**
 Viktoria Rawinski | Rawinski GmbH

Wenn trotz optimalem Lötprofil und maximaler Prozessstabilität ein Produktausfall auftritt, zeigen zwei Beispiele aus der Praxis, wie man der Ursache auf die Spur kommt. Bei einer Delamination steht schnell zu hohe Temperatur im Verdacht, doch die Ursache liegt in der Praxis oft tiefer. Überaltertes, falsch gelagertes Leiterplatten-Laminat oder falsches „Harz-Härter“-Mischungsverhältnis, um schneller fertigen zu können. Das Resultat? Eine glänzende, einwandfrei aussehende Leiterplatte – zumindest vor dem Lötprozess. Wenn das Kupfer aus den Vias beim Kontakt mit Lot binnen Sekunden verschwindet, ist der Verdacht oft auf Lötparameter gelenkt – zu Unrecht. Verunreinigungen beim Herstellen der Leiterplatte führen nicht nur zur vorzeitigen Auflösung des Kupfers, sondern auch zur Elektromigration zwischen den Leiterplattenlagen.

10:30 Uhr **NetworX – Tauschen Sie sich bei einer Tasse Kaffee mit den Experten und Teilnehmenden aus.**

11:00 Uhr **TechXperience 1**
 Sechs spannende TechXperiences warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. In unseren TechXperiences tauchen Sie in kleinen Gruppen tief in ein Thema ein. Erleben Sie Maschinen in Aktion, stellen Sie gerne Ihre konkreten Fragen, tauschen Sie sich über praktische Anwendungsbeispiele aus und diskutieren Sie mit unseren Experten. Bitte wählen Sie mit Ihrer Anmeldung 3 TechXperiences aus.

11:45 Uhr **NetworX – Die kurze Kaffeepause ist nach dem intensiven Wissenstransfer verdient.**

12:00 Uhr **TechXperience 2**
 Sechs spannende TechXperiences warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. In unseren TechXperiences tauchen Sie in kleinen Gruppen tief in ein Thema ein. Erleben Sie Maschinen in Aktion, stellen Sie gerne Ihre konkreten Fragen, tauschen Sie sich über praktische Anwendungsbeispiele aus und diskutieren Sie mit unseren Experten. Bitte wählen Sie mit Ihrer Anmeldung 3 TechXperiences aus.

12:45 Uhr **Mittagspause** – Genießen Sie das Buffet im Cateringbereich.

13:45 Uhr **Miniaturisierte SMD-Bauteile sicher wellenlöten – Herausforderungen und Lösungen**
 Helge Schimanski | Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie ISIT

Miniaturisierte SMD-Komponenten mit verdeckt liegenden Anschlussflächen stellen den Wellenlötprozess vor neue Herausforderungen.
 Ein prozesssicherer reproduzierbarer Kleberauftrag ist notwendige Voraussetzung für die Fertigung qualitativ hochwertiger Elektronik. In einer Fertigungsstudie wurden verschiedene Aspekte einer „Application Note“ für einen Baugruppenfertigungsprozess beleuchtet. Hierzu wurden ca. 3000 Komponenten bestückt und aus mehreren Varianten das optimale Leiterplattenlayout ermittelt sowie einschränkende Randbedingungen bei der Prozessierung thematisiert. Auf Basis der verifizierten Ergebnisse wurde eine Layout-Empfehlung erarbeitet, die in das Bauteildatenblatt implementiert wurde.

14:15 Uhr **Was wirklich am Produkt ankommt: Innovative Prüf- und Messsysteme für Wellen- und Selektivlötprozesse**
 Ulrich Wittreich | SIEMENS AG Foundational Technologies Berlin

Messen statt vermuten: Wellen- und Selektivlötprozesse liefern heute weit mehr als nur das Ergebnis „gut“ oder „schlecht“. Dieser Vortrag zeigt, wie innovative Prüf- und Messsysteme aus der Entwicklung von SIEMENS Foundational Technologies Berlin reale Prozessdaten direkt vom Produkt messbar machen. Anhand konkreter Beispiele aus der Fertigung wird gezeigt, wie Prozessdaten erfasst, ausgewertet und für mehr Stabilität, Qualität und Transparenz genutzt werden können. Ein Vortrag für alle, die Lötprozesse nicht nur fahren, sondern verstehen und gezielt verbessern wollen.

14:35 Uhr **NetworX** – Durchatmen, nachfragen oder einfach nur die Pause genießen.

15:00 Uhr **TechXperience 3**

Sechs spannende TechXperiences warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
 In unseren TechXperiences tauchen Sie in kleinen Gruppen tief in ein Thema ein. Erleben Sie Maschinen in Aktion, stellen Sie gerne Ihre konkreten Fragen, tauschen Sie sich über praktische Anwendungsbeispiele aus und diskutieren Sie mit unseren Experten.
 Bitte wählen Sie mit Ihrer Anmeldung 3 TechXperiences aus.

15:45 Uhr **Entwicklung und Integration von Phase Change Materials zur lokalen Begrenzung der Spitztemperatur**
 Dr.-Ing. Dirk Seehase | Universität Rostock

Wie lassen sich Leistungselektroniken zuverlässig vor kritischen Temperaturspitzen schützen? Aufbauend auf organischen Phase-Change-Materialien (PCM) mit klar definierten Temperaturgrenzen zeigt dieser Vortrag, warum deren physikalische Grenzen neue Wege erfordern – und wie metallische PCM völlig neue Potenziale eröffnen.
 Anhand konkreter Materialanalysen und praxisnaher Demonstratoren wird deutlich, wie sich Temperaturspitzen gezielt begrenzen lassen und welche konstruktiven Herausforderungen bei der Integration leitfähiger PCM in Leiterplatten zu meistern sind.
 Ein spannender Einblick in innovative Ansätze für ein effektives thermisches Management in der Leistungselektronik.

16:10 Uhr **Forschung @ SEHO: Ein Einblick in aktuelle Projektaktivitäten**
 Dr.-Ing. Andreas Reinhardt | SEHO Systems GmbH

SEHO engagiert sich kontinuierlich in Forschungsprojekten mit dem Ziel, Lötprozesse weiter zu stabilisieren und technologisch neu zu denken. Sie erhalten einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungsaktivitäten und zentrale Forschungsschwerpunkte. Wir zeigen, welche technologischen Fragestellungen wir gemeinsam mit Partnern adressieren und welchen konkreten Nutzen diese Erkenntnisse für die industrielle Elektronikfertigung bieten. Ein Einblick in unsere Innovationsarbeit und in die Grundlagen zukünftiger Technologien.

19:00 Uhr Abendprogramm im Kloster Bronnbach

Ein Shuttle-Transfer von und nach Wertheim stellt sicher, dass Sie den Abend unbeschwert genießen können.

Unsere TechXperiences

Bitte wählen Sie mit Ihrer Online-Anmeldung drei der nachfolgenden TechXperiences aus.

TX1: Selektiv-Lötanlagen	Lernen Sie die neue SEHO PowerSelective-HD und die aktuellen Features der SEHO SelectLine-C kennen.
TX2: Wellen-Lötanlagen	MWS 2300 - Maschinentechnologie, die begeistert. Vom neuen SectorFluxer über energieeffiziente Tunnelisolierung bis hin zur automatischen Wellenhöhenregelung.
TX3: Solder Copilot	Haben Sie sich je gefragt, wie es wäre, den Lötprozess für neue Produkte nicht über zeitraubende und kostspielige Tests optimieren zu müssen? Lernen Sie den Solder Copilot kennen!
TX4: Bestückkontrolle und AOI	Klare Ergebnisse im THT-Prozess: Kontrolliert und mit geringem Programmieraufwand zur Null-Fehler-Fertigung.
TX5: Automatisierungslösungen	Bei einem Rundgang durch unsere Fertigung zeigen wir Ihnen aktuelle Projekte aus dem Bereich der Automatisierungstechnik und applikationsspezifische Sonderlösungen.
TX6: THT-Lötfehler	Diskutieren Sie mit unseren Experten die möglichen Ursachen für typische THT-Lötfehler und wie sich diese vermeiden lassen.